



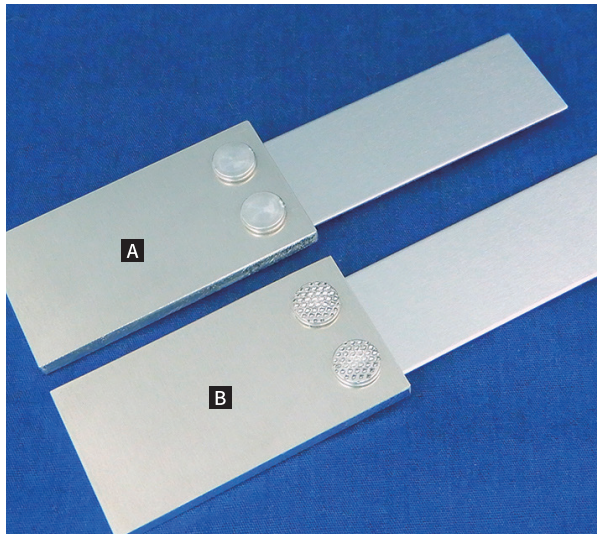
Patented

# Application

## Bonding ボンディング

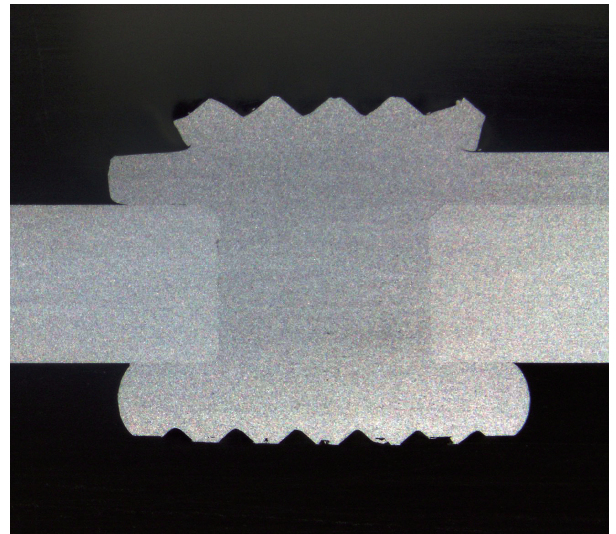
### アルミプレートのリベットかしめ接合

マルチ重ね多点同時接合



A かしめ前

B かしめ後



#### Point ここがポイント

- ✔ 接合で緩まないアルミかしめ固定法
- ✔ 音のみのエネルギーで介在物不要
- ✔ 大気中常温接合
- ✔ インゴット接合
- ✔ 接合時間約1秒
- ✔ 音波ツールやアンビルの発熱がほぼ無し

#### Product used 使用する装置

- ✔ 15MZs



AP-J-0079A4-2021110101